

正誤表

本当に実務に役立つ
プリント配線板のエッチング技術

ページ、行など	誤	正	備考
p.9, 13行	Printed Circuit))	Printed Circuit)』	
p.36, 図 1.20 の説明文	NBS「により	NBS IIにより	
p.47, 9行	5. 中川登志子: “黒化処理に代わるMEC etchBOND”, 電子材料, (1995年10月)	5. 牧善朗, 中川登志子: “黒化処理に代わる「MEC etch BOND」”, 電子材料, Vol.34, No.10, pp.26-30 (1995年10月)	
p.56, 図 2.8 の 下	(記入なし)	From Chapter 34, written by Marshall I. Gurian, of Printed Circuit Handbook Sixth Edition, published by The McGraw-Hill Companies, 2008. Reproduced with permission of The McGraw-Hill Companies.	
p.63, 表 2.1, 12行(第10項目)	平均長さ	要素の平均長さ	
p.68, 8行	細長いパターンに下降し、	細長いパターンに加工し、	
p.76, 14行	1994 改正	1994 年改正	
p.81, 3行	写真 3.3	図 3.3	
p.88, 13行	写真 3.8 の(d)	図 3.14 の(d)	
p.94, 12行	保障	保証	
p.95, 6行	異常析出間問題	異常析出問題	
p.95, 9行	1.2.5 項	1.2.4 項	
p.106, 9行	表面から見た状況と断面写真を示す。	表面から見た状況を示す。	
p.113, 13行	絶対全体温度	絶対温度	
p.122 下部	図 5.8 打力のモデル分析に使用したフルコーン型スプレーノズルのフローパターン	図 5.8 金属表面の液膜の概略図	
p.124 図 5.9 下部	(記入なし)	Reproduced by permission of ECS – The Electrochemical Society	
p.125 図 5.10 下部	(記入なし)	Reproduced by permission of ECS – The Electrochemical Society	
p.126, 9行	一緒に噴射される	一緒に噴射される	
p.139, 4行	[EXE] は	「EXE」は	
p.148, 13行	鉄の存在化では	鉄の存在下では	
p.150 図 5.33 左下部	Cu ₂ SO ₄	CuSO ₄	
p.150 図 5.33 左下部	Cu ₂ SO ₄	CuSO ₄	

(次ページに続く)

正誤表

本当に実務に役立つ
プリント配線板のエッチング技術

ページ、行など	誤	正	備考
p.153 脚注	<code>solve_rec(C[k]*(A+1)=C[k-1]*A+C[k+1],C[k],C[0]=C0,C[n+1]=0);</code>	<code>solve_rec(C[k]*(A+1)=C[k-1]*A+C[k+1],C[k],C[0]=C0,C[n+1]=0);</code>	

2009年7月12日

最新の情報は <http://www.etching-tech.com> を参照ください。